

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 56151516
PUBLICATION DATE : 24-11-81

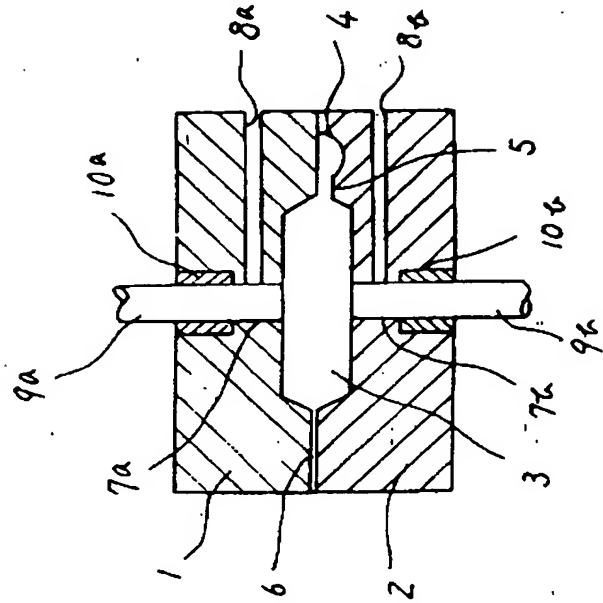
APPLICATION DATE : 28-04-80
APPLICATION NUMBER : 55055462

APPLICANT : HITACHI LTD;

INVENTOR : YOKONO ATARU;

INT.CL. : B29C 1/00

TITLE : MOLD FOR PLASTIC MOLDING



ABSTRACT : **PURPOSE:** To obtain the captioned mold improved in the mold release characteristics of a molded form, especially, the same of a semiconductor precise molded form by a method wherein guide holes, communicating with a cavity, and gas introducing ports, intersecting said guide holes, are provided in the upper and lower molds.

CONSTITUTION: A top force 1 and a bottom tool 2 are closed and valve pins 9a, 9b are inserted into the guide holes 7a, 7b provided in the upper and lower molds 1, 2 so as to be communicated with the cavity 3, thus the cavity 3 is closed. A molding material is poured through a liner 4 and a gate 5 to effect the molding. Subsequently, the valve pins 9a, 9b are retreated and pressurized gas is introduced through the gas introducing holes 8a, 8b inbetween the molded form and the wall surface of the cavity 3. Subsequently, the upper and lower molds 1, 2 are opened and the molded form is released from the molds easily.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

① 日本国特許庁 (JP)

④ 特許出願公開

② 公開特許公報 (A)

昭56-151516

⑤ Int. Cl.³
B 29 C 1/00

識別記号

庁内整理番号
8016-4F

③ 公開 昭和56年(1981)11月24日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑥ プラスチック成形用金型

⑦ 発明者 若島喜昭

小平市上水本町1450番地株式会
社日立製作所武蔵工場内

⑧ 特 願 昭55-55462

⑨ 出 願 昭55(1980)4月28日

⑩ 発 明 者 海老名尚武

横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内

⑪ 発 明 者 金田愛三

横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内

⑫ 発 明 者 横野中

横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内

⑬ 出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5
番1号

⑭ 代 理 人 弁理士 福田幸作 外1名

明 細 書

発明の名称 プラスチック成形用金型

特許請求の範囲

1. プラスチック成形用金型において、上金型および下金型に、キャビティと連通するガイド穴、ならびにこのガイド穴と対向するガス導入孔を設け、前記ガイド穴内を移動できるとともに、そのガイド穴を閉止するバルブピンを設け、成形時には前記バルブピンの先端を前記キャビティのキャビティ面と密着し、成型時には前記バルブピンを後退させ、前記ガス導入孔と前記キャビティを連通させて、成形品と前記キャビティの端面との間にガスを導入するように構成したことを特徴とするプラスチック成形用金型。

発明の詳細な説明

本発明はプラスチック成形用金型に係り、特にその成型方式の改良を旨としたプラスチック成形用金型に関するものである。

従来のプラスチック成形用金型においては、成

(1)

形品のキャビティよりの成型は、突出しピン方式であつた。この方式においては、前記突出しピンによつて成形品を突出して成型するようにしてゐるので、成型性の悪い半導体モールド品（例えばエポキシ樹脂により半導体を封止したもの。以下単に成形品という）の場合、成型時に成形品のピン抜き部のみ大きな力がかかることにより、ベレットシラック、片面はく離等成形品の破損が多量に生じていた。

またその後の脱模成形品でも脱模成形品では、寸法変化、変形が起生し、前記突出しピン方式による脱模が不適当なものもあつた。

本発明は、上記した従来技術の欠点をなくし、半導体モールド品の成型時の破損を無くし、歩留りを向上するとともに、脱模成形品の脱模時の寸法変化、変形を無くし、歩留を向上することができ、プラスチック成形用金型の提供を、その目的とするものである。

本発明のプラスチック成形用金型の特徴は、プラスチック成形用金型において、上金型および下

(2)

金型、キャビティと通ずるガイド穴、ならびにこのガイド穴と対応するガス導入孔を形成し、前記ガイド穴内を移動できるとともに、そのガイド穴を閉止するバルブピンを設け、成形時には前記バルブピンの先端を前記キャビティのキャビティ面と面一にし、成形時には前記バルブピンを後退させ、前記ガス導入孔と前記キャビティを連通させて、成形品と前記キャビティの連通との間にガス圧を導入するように構成したプラスチック成形金型である。

さらに詳しくは、従来のプラスチック成形用金型における、成形品の突出しピンによる突出しを防止し、それを代えてキャビティに高圧ガスを送り込むバルブピンをガスエジェクタ機構として組込み、前記成形品をキャビティより脱型する時は前記バルブピンにより止められていた外部より導入の高圧ガスを、前記バルブピンを動作させることによりキャビティに流入させ、キャビティ壁面と前記成形品の端面を押し広げるようにしたものであり、この方式では成形品のせまい部分に強大な

(3)

図2図は、第1図の発明例に係る、半導体ワールド用の成型動作を示す断面図であり、第2図(1)は、成形品が充満された状態の状態を示し、第2図(2)は、バルブピンを後退させて高圧ガスをキャビティ内に導入させた状態を示し、第2図(3)は、脱型時の状態を示すものである。

第2図(1)において、上金型1、下金型2は閉じられており、さらにバルブピン9a、9bの先端はキャビティ面と面一の所で停止している。この時ガス導入孔8a、8bに少なくとも2気圧以上のガスを導入するが、成形段階でこのガスをガス導入孔8a、8bに閉じられておいても構い構い構い。このような状態で充満された状態は硬化反応反応が起るまでである。

次の工程を図2(2)で説明する。硬化反応が終了した時点で、バルブピン9a、9bを成形用エジェクタプレート（図示せず）もしくはエアシリンダ（図示せず）等により後退させ、ガス導入孔8a、8bとキャビティ3を連通させて、ガス導入孔8a、8bに導入されていた高圧ガスを

(4)

図3図は、第1図の発明例に係る、プラスチック成形金型の断面図である。

図3図は、第1図の発明例に係る、プラスチック成形金型の断面図である。

以下本発明を実施例によって説明する。

第1図は、本発明の一例に係るプラスチック成形用金型の断面図である。

この第1図において、1は上金型、2は下金型、3は、上金型1と下金型2とで形成されたキャビティ、4はランナ、5はゲート、6はガスピントである。

7a、7bは、キャビティ3と通ずり、それぞれ上金型1、下金型2に形成されたガイド穴、8a、8bは、ガイド穴7a、7bと接続し、それぞれ上金型1、下金型2に形成されたガス導入孔、9a、9bは、それぞれガイド穴7a、7bをスライドするおきの位置のバルブピン、10a、10bは、それぞれガイド穴7a、7bに設置され、ガイド穴7a、7bとバルブピン9a、9bとの間のガスもれを防止するとともに、バルブピン9a、9bの損傷防止の機構と、損傷部の摩擦防止を計ったガスケットである。

このように構成した本実施例の動作を説明する。

(4)

キャビティ3に流入させる。高圧ガスは、成形品13が硬化反応し、脱型動作を生じたキャビティ3と成形品13の間に侵入し留まる。

次に上金型1と下金型2を開くと、さらに高圧ガスは流入相転を促進するためにパーティング剤まで塗し、第2図(3)で示す如く、同時に上金型1、下金型2からの完全脱型が完了する。

第3図は、本発明の他の例に係る、プラスチック成形用金型の断面図である。

この第3図において、第1図と同じ番号を付したものは同一部分である。そして11a、11bは、その大径部がキャビティ3に開口し、前記大径部と小径部とからなるガイド穴であり、これらガイド穴11a、11bは、それぞれ上金型1a、下金型2aに形成されている。

12a、12bは、前記ランナ部からなるバルブピンであり、これらバルブピン12a、12bのランナ部とガイド穴11a、11bの小径部（内径部）は、ガス圧の導入時に気密性が保たれるように嵌合されている。

(6)

このように構成した本発明例の成型動作は、第1図に示る前記実施例と同様である。

すなわち、成形時には、バルブピン12a, 12bの先端(頂部)をキャビティ面と面一にし、脱型時には、バルブピン12a, 12bを後退させ、ガス導入孔8a, 8bとキャビティ3を通過させて、成形品(図示せず)とキャビティ3の端面との間にガス圧を導入することによって前記成形品を成型する。

以上の実施例には、次のような効果がある。

- (1) 脱型時、成形品全体に脱型力が分散負荷されるので、半導体モールド品の局部変形によるインサート(半導体のチップもしくはフレーム)の界面剥離がなくなり耐湿性が向上するとともに、半導体のチップのクラック発生がなくなり、成形歩留りの向上が計れる。
- (2) 成型時、成形品全体に成型力が分散負荷されるので、精密成形品の成型時における寸法変化、変形がなくなり、精密成形品の精度が向上する。
- (3) 従来の突出しピン方式では、成形品の過大な

(7)

プラスチック成形用金型を提供することができる。

図示の図解を説明

第1図は、本発明の第一実施例に係るプラスチック成形用金型の断面図、第2図は、第1図の実施例に係る、半導体モールド品の成型動作を示す断面図であり、第2図(1)は、成形品が充満された直後の状態を示し、第2図(2)は、バルブピンを後退させて高圧ガスをキャビティ内に導入させた状態を示し、第2図(3)は、脱型時の状態を示すものである。

第3図は、本発明の他の実施例に係る、プラスチック成形用金型の断面図である。

1, 1A…上金型、2, 2A…下金型、3…キャビティ、7a, 7b…ガイド穴、8a, 8b…ガス導入孔、9a, 9b…バルブピン、11a, 11b…ガイド穴、12a, 12b…バルブピン。

代理人 弁護士 福田華作

(ほか1名)

(8)

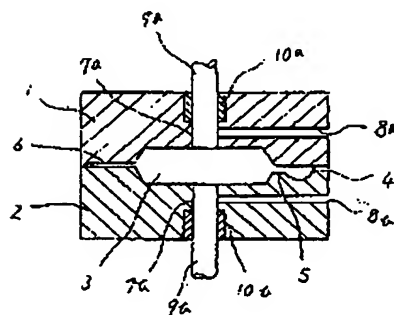
特開2005-151516(3)

変形を防止するため、成形品1枚に対して少なくとも2本の突出しピンを配置する必要があつたが、本実施例では、バルブピンは1本で充分である。したがって、プラスチック成形用金型の簡素化、小形化が計れ、金型製作費が従来の約2/3になる。

以上本発明に説明したように本発明によれば、プラスチック成形用金型において、上金型および下金型に、キャビティと連通するガイド穴、ならびにこのガイド穴と交差するガス導入孔を設け、前記ガイド穴内を移動できるとともに、そのガイド穴を閉止するバルブピンを設け、成形時には前記バルブピンの先端を前記キャビティのキャビティ面と面一にし、脱型時には前記バルブピンを後退させ、脱型ガス導入孔と前記キャビティを連通させて、成形品と前記キャビティの端面との間にガス圧を導入するように構成したので、半導体モールド品の成型時の変形をなくし、歩留りを向上するとともに、精密成形品の成型時の寸法変化、変形をなくし、精度を向上することができる、プ

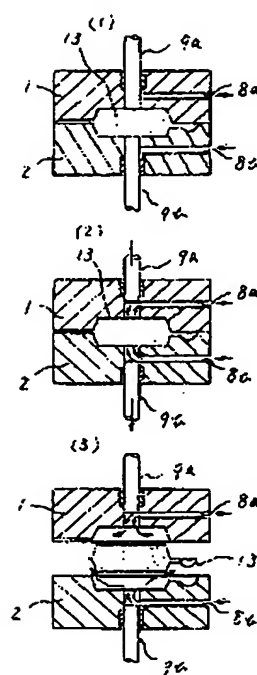
(9)

第1図

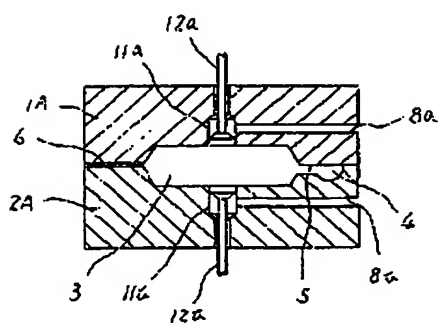


特開2005-151518(4)

第2図



第3図



昭 60 8.13 発行

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 55 年特許願第 55462 号(特開 昭 56-151516 号, 昭和 56 年 11 月 24 日 発行 公開特許公報 56-1516 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 2 (4)

Int. Cl. 1	識別記号	庁内整理番号
B29C 45/02		7179-4E
93/46		8415-4F
45/14		7179-4F
45/43		8117-4F
// B29K 191:10		0000-4F
B29L 31:34		9900-4F

手 続 補 正 書 (自 発)

昭和 60 年 3 月 22 日

特許庁長官 様

事件の表示

昭和 55 年 特許願第 55462 号

発明の名称 フォラスチック成形用金型

補正とする者

本件との関係 特許出願人

名 称 (510) 株式会社 日 立 鋼 管 所

代 理 人

所 在 (〒317) 茨城県日立市鹿嶋町一丁目10番3号

茨和ビル

電話 日立(0294)24-5793

氏 名 (7987) 弁護士 堀 岡 幸 作



60.3.22

補正の対象

明細書の、図解部分の略図の補、発明の評価を説明の欄。

補正の内容

- (1) 特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。
- (2) 明細書第2頁第20行の「上金型および下」を削除する。
- (3) 明細書第3頁第5行ないし第7行の「後述」を「移動」と訂正する。
- (4) 明細書第4頁第10行ないし第12行を、次のとおり訂正する。
「れ金型に係る上金型1。下金型2に穿設されたガイド穴、8a、8bは、ガイド穴7a、7bと対応して、それぞれ金型に係る上金型1、下金型2に穿設されたガス導入孔。」
- (5) 明細書第5頁第18行の「後述」を「移動」と訂正する。
- (6) 明細書第8頁第8行の「上金型および下」を削除する。
- (7) 明細書第8頁第14行ないし第15行の

「後述」を「移動」と訂正する。

昭 60 8. 13 発特

特許請求の範囲

1. プラスチック成形用金型において、金型体、キャビタイと連通するガイド穴、ならびにこのガイド穴と交差するガス導入口を具備し、前記ガイド穴内を移動できるともて、そのガイド穴を閉止するバルブピンを設け、成形時には前記バルブピンの先端を前記キャビタイのキャビタイ面と当接し、脱型時には前記バルブピンを後退させ、前記ガス導入口と前記キャビタイを連通させて、成形品と前記キャビタイの後面との間をガス圧を吸入するように構成したことを特徴とするプラスチック成形用金型、